



Vedi scheda
prodotto online

/ ORACL



/ Vantaggi

- Design solido e robusto
- Regolazione rapida di 4 profondità di taglio
- 4 profondità di incisione
- Fessure sul retro dell'utensile che facilitano la presa del semiconduttore dopo l'incisione

/ Settori di attività

-  Cavi e connettori
-  Distribuzione di elettricità
-  Industria

/ Specifiche tecniche

- **Utensili specifici** : Utensili per cavi
- **Utensili per cavi** : Utensili per la preparazione dei cavi
- **Settori di attività** : Cavi e connettori, Distribuzione di elettricità, Industria
- **Per i cavi di rete** : : Media tensione
- **Imballaggio** : scatola di cartone
- **Peso (g) (g)** : 160
- **Lunghezza (mm)** : 135
- **Larghezza (mm)** : 55
- **Altezza (mm)** : 35
- **Diametro massimo (mm)** : 100
- **Mini diametro (mm)** : 10
- **quotazione restante MIN (mm)** : 10 (gaine) / 4 (écran)
- **Profondità di incisione MAX (mm)** : 1.1
- **Profondità di taglio longitudinale (mm)** : 0.4 / 0.6 / 0.9 / 1.1
- **Tipo di strumenti** : Strumenti specifici

/ Parti di ricambio

	Riferimento	Descrizione
	LSO	Blade for cutting the peelable semiconductor of MV cables